

股票简称:晶华微

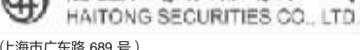
股票代码:688130



杭州晶华微电子股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室

保荐机构(主承销商):

海通证券股份有限公司
HAI TONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路 689 号)

2022 年 7 月 28 日

特别提示

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“晶华微”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,次交易日起涨跌幅限制比例为 10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为 20%,首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期,原始股东持有的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,发行人员工专项资产管理计划股份锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 66,560,000 股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 14,835,806 股,占本次发行后总股本的比例为 22.29%。上市公司初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(165),截至 2022 年 7 月 15 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(165)最近一个月平均静态市盈率为 44.88 倍。本次发行价格对应的市盈率为:

(1) 40.65 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 47.57 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 54.19 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4) 61.01 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险,保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会增加投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品比例,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述“报告期”指 2019 年、2020 年、2021 年。

(一) 技术和产品被替代的风险

公司主营业务的 SoC 芯片系基于 Sigma-Delta 电路结构为基础的高精度 ADC 技术,针对下游具体领域的应用需求,研究和创新电路细节,在特定工艺及成本的条件下实现高精度、低噪声、低耗电、高集成度等性能,并完善其相关高性能模拟信号链路资源设计,辅以成熟算法,推出了医疗健康、SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等系列产品。

从目前的技术路径来看,相比于“模拟分立运放+ADC+ 通用 MCU”的多芯片组合方案,SoC 单芯片在集成度、稳定性、量产成本、使用灵活性等方面更加出色。但多芯片组合方案在某些特定应用范围上可能具有一定优势,如在超高端数字万用表领域,由于其功能程序要求十分复杂,导致部分型号很难采用 SoC 单芯片解决方案实现兼容或替代,需配置高性能的更模拟前端类芯片与具备不同数字资源的通用型 MCU 芯片组合。随着半导体技术的不断发展,未来若多芯片组合在产品可靠性、生产成本等方面取得突破性进展,或其他拥有高精度 ADC 技术的公司更多地进入公司目前聚焦的应用领域,则将对公司所在的市场需求造成不利影响,进而影响公司业绩。

(二) 2020 年因疫情对公司收入快速增长,公司未来业绩存在可能无法持续增长或下滑的风险

2020 年,公司业绩呈现出较高的成长性,主营业务收入从 2019 年的 5,973.32 万元增长至 19,729.21 万元,同比增长 230.29%,主要系受新冠疫情拉动红外测温枪等防疫物资需求的影响,红外测温信号处理芯片终端需求激增,使得公司红外测温信号处理芯片销售收入在 2019 年的 1,128.74 万元增长 2020 年的 12,764.97 万元,实现大幅增长;2021 年,随着国内疫情逐步得到控制,红外测温信号处理芯片终端需求有所回落,当期公司红外测温信号处理芯片销售收入从上年的 12,764.97 万元下降至 3,016.05 万元,同比收入下降。因此,公司 2020 年业绩大幅增长主要系新冠疫情拉动的产品需求,具有偶发性。

报告期内,若剔除红外测温信号处理芯片形成销售收入后,公司其他芯片产品的销售收入分别为 5,484.95 万元、6,964.24 万元和 14,312.42 万元,年均复合增长率为 71.88%。若未来公司医疗健康 SoC 芯片中的其他系列芯片、工业控制及仪表芯片和智能感知 SoC 芯片等下游需求下降、上游成本费用上升,或主要客户出现变动,进而导致产品的销量或毛利率下降,可能对公司销售收入和经营业绩产生不利影响,公司业务规模存在可能无法持续增长或下滑的风险。

(三) 公司业务规模相对较小,业务相对集中的风险

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险,保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会增加投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保品比例,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

四、市场竞争风险

集成电路设计行业公司众多,市场竞争逐步加剧。公司主要从事高精度模拟及数模混合集成电路的研发与销售,该类芯片市场的快速发展以及技术产业链的成熟,吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。目前公司的主要竞争对手中,有国际上的集成电路巨头进入,并研发相关产品。公司未来业绩存在可能无法持续增长或下滑的风险。

(五) 毛利率下滑风险

报告期内,公司综合毛利率分别为 62.72%、73.09% 和 68.61%,毛利率水平较高,公司综合毛利率主要受产品结构、市场需求、销售价格等多种因素影响。2020 年公司综合毛利率同比增加 10.37 个百分点,主要原因是受新冠疫情的影响,红外测温枪等防疫物资需求量较大,导致公司医疗健康 SoC 芯片中的红外测温信号处理芯片产量和销量均出现较大幅度的增长,使得公司当年综合毛利率大幅提升。2020 年,随着疫情防控形势,下游市场对红外测温枪等防疫物资需求量较往年有所下降。

未来,如果公司医疗健康 SoC 芯片中的其他系列芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等其他芯片未能实现大量出货,或者公司未能综合市场需求率先推出新产品,或新产品未能如期实现大量销售,将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

(六) 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为吕汉泉与罗洛仪夫妇。本次发行前,吕汉泉直接持有公司 57.69% 的股份,通过景宁晶华间接控制公司 9.10% 的股份,罗洛仪直接持有公司 14.34% 的股份,同时,罗洛仪与罗洛仪系兄妹关系,为实际控制人的一致行动人,其直接持有公司 9.01% 的股份。因此,吕汉泉、罗洛仪夫妇及其一致行动人合计控制公司 90.14% 的股份。本次发行完成后,实际控制人及其一致行动人控制权的比例将下降至 67.61%,仍处于绝对控制地位。

如果实际控制人利用其自身地位通过股东大会行使表决权,对公司的重大经营决策、董事选举、股权分配政策制定、公司章程修改、对外投资等重大事项进行不当控制,将可能对本公司及其他股东特别是中小股东的利益产生不利影响。

(七) 核心技术人员引进不足及流失风险

集成电路设计行业属于技术密集型行业,核心技术人才是公司保持竞争优势的基础,也是公司持续技术创新的推动力。因此公司对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业。截至目前,公司拥有员工人数为 109 人,其中研发人员 70 人,占员工总人数的 64.22%。目前集成电路设计行业正处于蓬勃发展时期,国内拥有上百家集成电路设计企业,对集成电路关键技术人才需求缺口较大,运用高薪或者股权激励等方法吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段,导致行业内人员流动愈发频繁。

未来,如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管理及内部晋升制度得不到有效执行,公司将无法引进更多的核心技术人员,甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情况,对公司生产经营产生不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

截至本上市公告书出具日,发行人董事的基本情况如下:

1、董事情况

截至本上市公告书出具日,发行人董事由 7 名董事组成,包括 3 名独立董事、2 名副总经理、1 名财务总监兼董事会秘书;核心技术人员 4 名,具体如下:

1、董事情况

截至本上市公告书出具日,发行人董事的基本情况如下:

2、股票上市情况

截至本上市公告书出具日,发行人股票上市的基本情况如下:

3、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

截至本上市公告书出具日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下:

4、股票上市的有关信息

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

5、保荐机构、承销团成员、上市地及上市时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

6、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

7、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

8、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

9、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

10、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

11、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

12、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

13、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

14、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

15、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

16、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

17、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

18、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

19、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

20、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

21、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

22、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

23、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

24、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

25、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

26、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

27、上市公告书的披露地点

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

28、上市公告书的披露时间

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

29、上市公告书的披露文件

截至本上市公告书出具日,本公司股票上市的有关信息如下:

30、上市公告书的披露地点